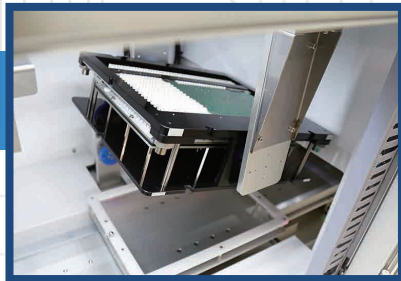


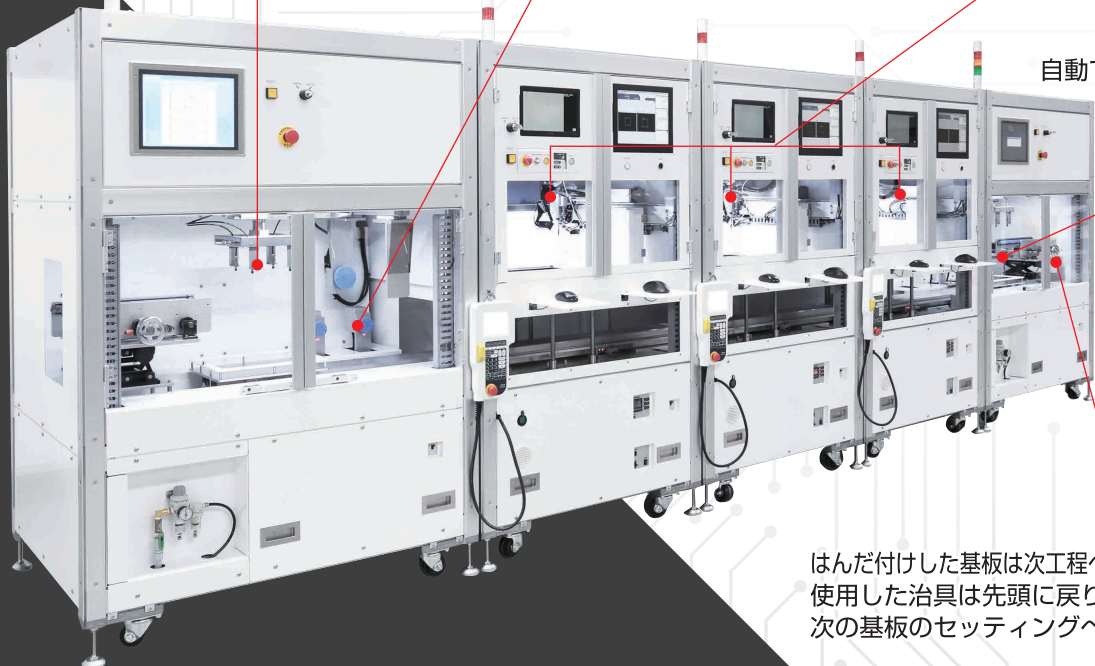
ディスクリート部品実装基板を
マルチ治具へ搬送



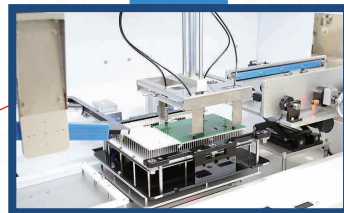
マルチ治具にセッティング



適切な環境ではんだ付け作業を実行



自動で基板を搬出



はんだ付けした基板は次工程へ
使用した治具は先頭に戻り
次の基板のセッティングへ



投入・セッティング装置

SR-IST

基本仕様

- 装置寸法：
1200mm(W)×950mm(D)×1700mm(H)
- 装置重量：
300kg
- 入力電源電圧：
1φ AC200V±10% 50/60HZ
- 消費電力：
1.5kW
- 適応基板サイズ：
120mm×80mm～275mm×190mm

はんだ付けロボット装置

SR-SOR

基本仕様

- 装置寸法：
996mm(W)×950mm(D)×1700mm(H)
- 装置重量：
300kg
- 入力電源電圧：
1φ AC200V±10% 50/60HZ
- 消費電力：
1kW
- 適応基板サイズ：
120mm×80mm～275mm×190mm

分離・排出装置

SR-SPD

基本仕様

- 装置寸法：
1200mm(W)×950mm(D)×1700mm(H)
- 装置重量：
300kg
- 入力電源電圧：
1φ AC200V±10% 50/60HZ
- 消費電力：
1kW
- 適応基板サイズ：
120mm×80mm～275mm×190mm